

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，实际募集资金金额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至本公告披露日，本公司募集资金专户情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账户	专户用途	账户状态
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001822	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	正常
2	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	正常
3	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005261995	补充流动资金	本次注销
4	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	正常

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司在上海银行股份有限公司天津华苑支行开立的募集资金专户（账号：03005261995）余额为0元，且该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司天津分行签订的关于该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年12月10日